

DEAR サミット(第三回)

日 時:2021 年 12 月 18 日(土)

実施方法:オンライン形式

第三回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの実施で準備を進めました。参加学生たちもオンライン形式に慣れた様子でした。また、参加学生の中には、オンラインだと緊張感が軽減され参加しやすくなったという声もありました。

当日は、6名の学生が参加しました。

プログラム

第一部

社会移行支援プロジェクト報告

企業紹介

第二部

DEAR サミット(1社30分、最大3社まで相談可能)

<協力企業一覧(50音順)>

- ・オムロンエクスパートリンク株式会社
- ・株式会社島津製作所
- ・株式会社堀場製作所
- ・ソニーグループ株式会社
- ・ヤフー株式会社



Kyoto University
Disability Resource Center

学生総合支援機構 障害学生支援部門